

粘弹性材料界面裂纹应力场奇性分析

魏培君, 章梓茂, 汪越胜, 张双寅

北京科技大学应用科学学院数学力学系

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要

关键词

分类号

”

北京科技大学应用科学学院数学力学系

Abstract

Key words

DOI:

通讯作者 weipj@126.com

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(535KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [复制索引](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 无 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [魏培君](#)

· [章梓茂](#)

· [汪越胜](#)

· [张双寅](#)